

放熱樹脂材料ラインナップ

Heat dissipation material lineup

特長 Features

- 大電流、高放熱、高密度化など多彩な用途に対応した基板技術を御提供。
Large current, high heat dissipation, and high density technologies for various applications.
- 量産メーカーとして量産性、高信頼性を確保した技術開発を実践。
As a mass-production PCB manufacturer, we practice technological development that ensures mass productivity and high reliability.

	熱伝導率 W/m・K	膜厚 μm	絶縁破壊電圧 AC/kV	特長	ステータス
M2	1.7	80	4	汎用・UL対応	量産
M3T	2.5	70/100	6.5/7.5	汎用	*開発中
L3TV	3.2	105	3.5	車載・低弾性	量産
H5R	5.0	120	4	車載・汎用	量産
H7S	7.0	80/120	4.8/6.4	車載・UL対応	量産
H10R	10.0	120	5	高耐熱	*評価中
H12T	11.6	120	5	汎用	*開発中
H16M	16.5	150	8	高耐圧	量産

用途 Application

- LED照明、2輪／4輪インバータ、産機・民生用インバータ

構造 Structure

		材料	用途
アルミベース基板		アルミ:A1050, A5052 M2, M3T, L3TV, H5R, H12T	LED照明、産機、 電動パワステEPS
銅ベース基板		銅:C1100, C1020 M2, M3T, L3TV, H5R, H7S, H12T, H16M	パワーモジュール
多層メタルベース基板		M2, *M3T, *H5T, *H10T	2輪／4輪インバータ

*開発中